

中信建投证券股份有限公司
关于合肥顾中科技股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司名称：合肥顾中科技股份有限公司
保荐代表人姓名：吴建航	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
保荐代表人姓名：廖小龙	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕415 号文”批准，合肥顾中科技股份有限公司（简称“公司”或“顾中科技”）向社会公开发行人民币普通股 200,000,000 股。公司本次发行新股的发行价为 12.10 元/股，募集资金总额人民币 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 187,373,816.76 元后，募集资金净额人民币 2,232,626,183.24 元。本次公开发行股票于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本 2025 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并结合持续督导各项工作事宜制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐人已与顾中科技签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、	保荐人通过日常沟通、定期或不定期

	工作内容	持续督导情况
	尽职调查等方式开展持续督导工作。	期回访、现场检查、查阅相关公开信息进行尽职调查等方式，了解顾中科技经营、股票交易等情况，对顾中科技开展持续督导工作。经核查，本持续督导期内，上市公司不存在持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	保荐人通过现场检查、现场培训等措施，督导公司遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件。经核查，本持续督导期内，顾中科技未出现按有关规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	保荐人取得了上市公司及相关当事人的各项承诺，逐一核查承诺履行情况。经核查，本持续督导期内，顾中科技及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐人通过现场检查、现场培训等措施，督导顾中科技及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。经核查，本持续督导期内，顾中科技及其董事、高级管理人员均遵守相关法律法规及规范性文件，不存在违反承诺的情形。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等。	保荐人督促顾中科技依照相关规定健全完善公司治理制度并严格执行，取得了各项制度，并对重大投资、关联交易等事项进行了核查。经核查，本持续督导期内，公司已建立健全并有效执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、	保荐人对顾中科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募

	工作内容	持续督导情况
	对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等，并了解其内部审计的执行情况。经核查，本持续督导期内，顾中科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐人督促顾中科技严格执行信息披露制度，同时及时审阅信息披露文件及其他相关文件。经核查，本持续督导期内，公司已建立健全并有效执行信息披露制度，不存在信息披露更正或补充公告的情况，不存在向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐人对顾中科技的信息披露文件及其他相关文件进行了及时事前审阅，并查阅了相关公开信息及对相关主体进行访谈。经核查，本持续督导期内，公司不存在相关文件存在问题需进行信息披露更正或补充公告的情况，不存在不予更正或补充应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	保荐人督促顾中科技完善并严格执行内部控制制度，并通过现场检查、现场培训等措施，督导顾中科技及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件。经核查，本持续督导期内，顾中科技及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。

	工作内容	持续督导情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	保荐人取得上市公司及控股股东、实际控制人的各项承诺，逐一核查承诺履行情况，并查阅相关公开信息，访谈相关主体。经核查，本持续督导期内，顾中科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐人查阅了公司公告与相关公开信息，并对相关主体进行访谈。经核查，本持续督导期内，顾中科技不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的重大事项。
14	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	保荐人通过现场检查、现场培训等措施，督导顾中科技及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件。经核查，本持续督导期内，顾中科技未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计 划，明确现场检查工作要求，确保 现场检查工作质量。上市公司出现 以下情形之一的，应自知道或应当 知道之日起十五日内或上海证券交 易所要求的期限内，对上市公司进 行专项现场检查：（一）存在重大 财务造假嫌疑；（二）控股股东、 实际控制人及其关联人涉嫌资金 占用；（三）可能存在重大违规担 保；（四）控股股东、实际控制人 及其关联人、董事或者高级管理 人员涉嫌侵占上市公司利益； （五）资金往来或者现金流存在 重大异常；（六）上海证券交易所 要求的其他情形。	本持续督导期内，保荐人已针对上市公司制定了严格的现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。2025 年 1-6 月，公司未出现需要进行专项现场检查的情形。

	工作内容	持续督导情况
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	保荐人取得了上市公司及相关当事人的各项承诺,并持续关注相关承诺履行情况。经核查,本持续督导期内,公司上市公司及相关当事人未发生违反承诺履行的情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间,保荐人和保荐代表人未发现顾中科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间,公司主要的风险事项如下:

(一) 核心竞争力风险

1、宏观经济和行业周期波动的风险

目前,国际贸易摩擦不断,全球半导体市场面临较大压力,半导体产业仍处于周期性波动中,公司主营业务为集成电路封装测试服务,具有较强的周期性。例如,下游显示面板行业具有周期性较强、价格波动较大的特点,间接对显示驱动芯片及相关封测需求产生较大影响。同时,显示驱动芯片、电源管理芯片以及射频前端芯片等产品的下游终端主要为消费类电子,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、高清电视、智能穿戴、车载产品等,相关产品性能更新速度快、品牌及规格型号繁多使得需求变化较大,存在不确定性。

2、技术及产品升级迭代的风险

随着全球集成电路行业的不断发展及终端应用产品对集成电路相关性能的要求不断提高,集成电路对端口密度、信号延迟及封装体积等提出了越来越高的要求。以显示驱动芯片为例,一方面,显示屏幕分辨率、清晰度的提升意味着更多 I/O 数量,对凸块制造的密度、间距提出越来越高的要求,测试的复杂性也随之提升,后段封装的精准度和难度也大幅增加;另一方面,AMOLED、Mini Led、Micro Led 等新型显示技术正处于发展阶段,相关新型显示技术对已有显示技术的升级迭代将间接对显示驱动芯片封测技术产生一定影响。

如果公司无法根据行业发展趋势和下游客户需求进行技术与产品创新，或新开发的产品质量未能得到客户认可，或研发项目无法顺利实现商业化，将可能面临订单流失、市场地位下降的风险，从而对公司的核心竞争力造成不利影响。

（三）经营风险

1、行业波动及需求变化风险

受国际地缘政治冲突、经济环境的影响，近年来，集成电路行业需求出现较大波动。公司主营业务为集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品，集成电路行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。集成电路行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球集成电路产业市场出现较大波动，将对公司经营业绩带来较大的影响。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，各大封测厂商积极布局先进封装业务，在显示驱动芯片封测领域，除细分行业龙头颀邦科技、南茂科技继续在相关领域保持领先地位外，综合类封测企业通过自建或与其他方合作等方式对相关领域也进行积极布局。相较于行业内头部封测企业，公司在资产规模、资本实力、产品服务范围等方面存在一定差距，面对行业竞争加剧的局面，若公司不能较好地采取措施应对，可能会对公司业务开拓以及经营业绩产生不利影响。

3、非显示类业务开拓不利的风险

公司从 2015 年开始布局铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等非显示先进封装技术的研发，并于 2019 年完成后段 DPS 封装的建置，目前正在建置载板覆晶封装、BGBM/FSM、Cu Clip 制程。报告期内，公司非显示类业务虽增长较快但整体规模相对较小，非全制程占比较高，且主要集中在电源管理、射频前端等芯片领域，客户主要集中在中国境内，与长电科技、通富微电、华天科技等头部综合类封测企业相比综合实力具有较大差距。若综合类封测企业对相关细分领域进行大规模投入、非显示类客户导入不及预期或下游终端市场环境出现不利变化等情况，则存在非显示封测业务开拓不利的风险。

4、研发技术人才流失风险

集成电路封测行业是典型的技术密集行业，企业的技术研发实力源于对专业人才的储备和培养。虽然近几年中国大陆集成电路封测行业取得快速发展，从业人员逐步增多，但专业研发人才供不应求的情况依然普遍存在。由于近几年市场对于集成电路封测高端人才的需求急剧增加，人才招聘成本不断上升，未来一段时间，专业人才相对缺乏仍将成为制约行业发展的重要因素之一。若公司核心技术人才流失，将对公司的研发生产造成不利影响。

（四）财务风险

1、汇率波动风险

公司存在部分境外销售及境外采购的情况，并主要通过美元或日元进行结算。未来若人民币与美元或美元与日元汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

2、存货跌价风险

报告期，公司存货账面价值为 53,680.79 万元，占期末资产总额的比重为 7.75%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长。如果未来市场需求、价格发生不利变动，公司将面临存货跌价的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

3、商誉减值风险

2018 年 1 月，公司收购苏州顾中形成商誉 88,748.48 万元。报告期内，苏州顾中系公司封装测试业务主要经营主体，如果未来封装测试市场需求、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，而苏州顾中未能适应前述变化，则可能对苏州顾中的盈利能力产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

4、税收优惠存在不确定性的风险

报告期内，公司子公司苏州顾中享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率，若未来上述税收优惠政策发生变化或者子公司苏州顾中不再符合税收优惠条件，

则可能对公司的经营业绩和盈利产生不利影响。

5、合肥工厂新增折旧可能影响公司盈利水平的风险

公司合肥工厂项目厂房产于 2023 年末转为固定资产，与之配套的机器设备在达到预定可使用状态后陆续转固。报告期内，合肥工厂项目转固金额 17,541.66 万元，该部分固定资产将在未来一定期限内计提折旧。若合肥工厂的客户导入不及预期，公司销售收入增长可能无法消化每年新增折旧费用，公司存在毛利率下降及业绩下滑的风险。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，颀中科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减（%）
营业收入	995,760,921.23	933,872,295.84	6.63
归属于上市公司股东的净利润	99,191,402.40	162,024,179.46	-38.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,524,530.03	157,476,907.78	-38.71
经营活动产生的现金流量净额	234,190,993.63	316,388,303.49	-25.98
主要会计数据	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	本期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	6,073,902,073.00	6,003,292,022.20	1.18
总资产	6,930,277,295.35	6,991,013,658.68	-0.87

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86

主要财务指标	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.13	-38.46
加权平均净资产收益率 (%)	1.64	2.75	减少 1.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.59	2.67	减少 1.08 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	9.27	7.30	增加 1.97 个百分点

2025 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润减少，主要系业务扩张导致设备折旧、人力成本增加及研发投入增加，而收入规模尚未完全释放所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要系业务扩张导致设备折旧、人力成本增加及研发投入增加，而收入规模尚未完全释放所致。

3、报告期内，基本每股收益减少，主要系设备折旧、人力成本及研发投入增加，归属于上市公司股东的净利润相应减少所致。

4、报告期内，稀释每股收益减少，主要系设备折旧、人力成本及研发投入增加，归属于上市公司股东的净利润相应减少所致。

5、报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益减少，主要系设备折旧、人力成本及研发投入增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）技术研发优势

公司一贯坚持自主创新和精益求精的理念，始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。就显示驱动芯片封测业务而言，作为境内规模最大、进入

时间最早的显示驱动芯片封测厂商之一，公司在“微细间距金凸块高可靠性制造”、“大尺寸高平坦化电镀”、“显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术”等凸块制造技术以及“高精度高密度内引脚接合”、“125mm 大版面覆晶封装技术”、“高稳定性晶圆研磨切割技术”等后段封装技术方面积累了较多成功经验和技術成果，同时在高端设备技术改造、自动化系统方面具有较强实力，相关技术覆盖了整个生产制程，为公司产品保持较高竞争力提供了坚实保障。目前，公司已具备业内最先进 28nm 制程显示驱动芯片的封测量产能力。领先的技术优势及丰富的产品特点有助于公司在显示驱动芯片封测业务中保持较高的客户粘性和定价能力。

得益于公司在显示驱动芯片封测领域积累的丰富经验，公司在非显示类芯片封测领域的技术研发中也取得了阶段性成果，相继开发出铜镍金、铜柱、锡等金属凸块制造技术。其中，铜柱凸块可代替传统的打线封装，通过缩短连接电路的长度，以减小芯片封装面积和体积，从而克服芯片系统的寄生电容干扰、电阻发热和信号延迟等缺点；铜镍金凸块可通过重布线技术，在不改变前端芯片内部设计结构的情况下，在封装环节进一步优化芯片的线路布局，以低成本的方式实现降低芯片导通电阻、提升电性能的效果；锡凸块具有密度大、间距小、低感应、散热能力佳的特点，适用于细微间距的芯片产品，市场空间较大。同时，面对“后摩尔时代”芯片尺寸越来越小、电性能要求越来越高的技术发展趋势，公司建立了 DPS 和载板覆晶封装制程，助力实现更小尺寸和更高集成度的整套封装测试的解决方案。同时，公司依托在金属凸块技术方面的深厚积累，积极布局功率芯片前段正面金属化（FSM）、背面减薄及金属化（BGBM）工艺以及后段铜片夹扣键合（Cu Clip）封装工艺，以满足功率器件大电流、低导通阻抗的特性。

（二）高质量、高稳定性和高可靠性的产品优势

在集成电路行业这片广阔的科技海洋中，品质的稳定是破浪前行的关键。公司将风险思维及过程管理模式贯穿于研发、制造、检测的全流程，通过产品质量先期策划及生产件批准流程，严格把控产品质量形成的各阶段，以确保每一件产品都能达到最高标准，满足客户的需求。同时，公司一直致力于建立健全质量控制体系，通过了包括 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理體系、

ANSI/ESD S20.20 静电防护管理体系认证等为代表的一系列国际体系认证，并在内部建立了全方位、多层次和极其严苛的质量管理标准，有效地保证了产品的优质、稳定。

通过多年来精益求精的工匠精神，报告期内公司在凸块制造、COG/COP、COF、DPS 等各主要生产环节的生产良率可稳定在 99.95%以上。优异的品质管控能力为公司树立了良好口碑，也为公司业务开展奠定了坚实基础。

（三）技术改造与软硬件开发优势

集成电路的先进封装与测试领域涉及的工序较多且技术发展日新月异，需要对生产软硬件进行不断地升级改造以快速响应客户需求。公司一直致力于智能制造的投入与专业人才的培养，拥有一支 20 余人的专业化团队，具备较强的核心设备改造、配件设计以及自动化系统开发能力。

在核心设备改造方面，公司自主设计并改造了一系列适用于 125mm 大版面覆晶封装的相关设备，为大版面覆晶封装产品的量产奠定了坚实基础，并自行完成了核心 8 吋 COF 设备的技术改造以用于 12 吋产品，大幅节约了新设备购置所需的时间和成本；在高端设备配件及工治具设计方面，公司研发设计出高温测试治具装置，解决了测试温度均匀性问题，提升了晶圆测试效率和品质；在系统开发方面，自主研发出真空溅镀、电镀等关键节点参数智能化监控系统，并且开发出测试自动化体系，进一步提升了公司整体的工艺管控水平。出众的技术改造与软硬件开发能力是公司自主创新的重要体现。

（四）丰富的产品组合及特色工艺优势

公司可顺应客户要求，提供基于 8 吋、12 吋晶圆的全制程“一站式”封测业务，可极大提高产品的稳定性与可靠性，并有效减轻客户成本。针对电源管理芯片、射频前端芯片等产品对于高 I/O 数、高电性能、低导通电阻日益增长的需求，公司可提供如铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等先进凸块制造技术以及重布线、多层堆叠等特色工艺，也可提供全制程的 Fan-in WLCSP 量产服务以满足客户需求。此外，公司还可为客户提供各类配套服务，如凸块制造所需的光罩设计、探针卡的设计维修、薄膜覆晶卷带设计、测试程式开发等。丰富的产品组合和先

进的特色工艺为公司提供了极具市场竞争力的业务基础。

（五）地域优势

公司客户主要为集成电路芯片设计企业，其对交货时间要求严格，交货时间短和便利的地理位置可为集成电路芯片设计企业减少库存，节约运输时间和资金成本，及时应对来自客户的随机性和突发性需求，方便企业与客户交流和反馈，增强其竞争力。

公司注册地合肥市近年来在集成电路领域形成了一定的规模效应，目前已成为中国大陆集成电路产业发展最快、成效最显著的城市之一。合肥市被国家发改委和工信部列为集成电路产业重点发展城市，也是全国首个“海峡两岸集成电路产业合作试验区”和首批“国家集成电路战略性新兴产业集群”。合肥将集成电路产业作为重点发展的战略性新兴产业，构建了从设计、制造、封装测试、装备材料，到公共服务平台的完整产业链生态，已集聚产业链上下游重点企业数百家。晶合集成、京东方、维信诺等与公司相关的上下游企业均在合肥有所布局。

长三角地区是目前中国大陆集成电路产业的主要集群区域，已形成了芯片研发、设计、制造、封装测试以及相关物料和设备等较完整的集成电路产业链。江苏集成电路产业链完备、配套能力强，芯片设计与制造能力提升较快。全资子公司苏州颀中所在的苏州工业园区也汇集了和舰芯片、华星光电等公司上下游企业。

此外，公司在中国台湾设有办事处，可与当地 IC 设计客户保持更为紧密的沟通，有助于公司境外业务的开展。优越的地理位置为公司发展提供了丰沃土壤，有利于公司减少交货时间并节约运输时间、库存成本，同时有助于公司及时处理客户或下游企业的各类需求，方便与其直接交流和反馈，公司在成本控制、人才资源、专业技术上的优势将越发突出。

（六）团队经验丰富、具有创新精神的管理团队

公司的经营管理团队主要成员在集成电路先进封测行业拥有超过 15 年以上的技术研发和生产管理经验，具备国际一流先进封测企业的视野和产业背景。自设立以来，公司经营管理团队通过技术引进、消化吸收和自主创新，逐步积累和提高了以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为代表的先进封装技术及生产

管理能力。在管理团队的卓越带领之下，公司业务规模不断增长，行业地位显著提升。经验丰富且稳定的管理团队，有利于公司继续保持在行业内的领先地位，不断提升公司品牌效应。

（七）优质的客户资源和市场开发优势

凭借领先的先进封测能力、高品质的产品质量以及多品种的封测服务种类，公司赢得了境内外集成电路设计企业的广泛认可，并与众多国内外知名设计公司保持了良好且稳定的合作关系。在显示驱动芯片封测领域，公司积累了奕斯伟计算、格科微、联咏科技、敦泰电子、奇景光电、瑞鼎科技、谱瑞科技、晶门科技、集创北方、云英谷、通锐微等境内外知名的客户；在非显示类芯片封测领域，公司开发了昂瑞微、矽力杰、杰华特、南芯半导体、纳芯微、艾为电子、唯捷创芯、希荻微等优质客户资源。上述客户在集成电路相关领域具有较高的市场占有率和知名度。此外，公司拥有一支在集成电路上下游产业链具有丰富经验和人脉资源的业务团队，有利于公司更好地开拓和服务好客户。优质客户的深度及广度是公司重要的竞争优势。

七、研发支出变化及研发进展

公司始终重视研发体系建设、坚持以市场为导向，与客户紧密合作，坚持对技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障，建立了高素质的核心管理团队和专业化的核心研发团队。报告期内，公司研发投入 9,231.07 万元，较上年同期增长 35.32%。截至报告期末，公司研发人员数量增至 295 人，较上年同期增长 19.43%，研发人员数量占公司比例为 12.87%。同时，公司积极推进产学研合作，公司与合肥工业大学携手共建“研究生联合培养基地”，为培养高素质专业人才、推动产学研深度融合搭建了新的平台，通过深化校企学术合作与交流，强化合作项目对接与实施，形成“学术研究-产业实践”的双向赋能机制。

报告期内，公司获得授权发明专利 10 项（中国 4 项，国际 6 项）、授权实用新型专利 18 项，包括芯片封装结构及芯片封装方法、晶圆盒与半导体生产设备、用于覆晶薄膜封装的散热贴安装治具与生产设备、用于柔性基板卷带上料的自动收料机构与生产设备、芯片重布线结构及其制备方法、用于芯片封装的顶针装置、晶圆表面介电层的制备方法、晶圆结构及凸块的成型方法、电镀导电治具、用于

去除卷带芯片的芯片剔除装置等在内的授权专利均为自主研发，且上述技术大部分已在公司产品上实现了应用。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 14,488.61 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	242,000.00
减：支付发行有关费用	18,737.38
首次公开发行募集资金净额	223,262.62
减：使用募集资金金额	211,549.99
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	24,873.31
直接投入募投项目金额	172,876.68
使用超募资金永久补充流动资金金额	13,800.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,416.63
减：补流资金利息收入扣除手续费净额转出	640.65
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户应结余额	14,488.61
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	14,488.61
差异金额	0.00

报告期内，公司于 2025 年 6 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥顾中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《合肥顾中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

1、实际控制人

截至 2025 年 6 月 30 日,公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、控股股东

截至 2025 年 6 月 30 日,公司控股股东合肥硕中科技控股有限公司持有公司 397,127,159 股,持股比例为 33.40%。

3、董事、监事和高级管理人员

截至 2025 年 6 月 30 日,公司董事、监事和高级管理人员的持股情况如下:

序号	名称	任职	持股数量(万股)	持股比例
1	陈小蓓	董事长	-	-
2	赵章华	董事	-	-
3	罗世蔚	董事	5.34	0.0045%
4	黄玲	董事		
5	杨宗铭	董事、总经理	305.06	0.26%
6	余成强	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	189.24	0.16%
7	胡晓林	独立董事	-	-
8	崔也光	独立董事	-	-
9	王新	独立董事	-	-
10	杨国庆	监事会主席	-	-
11	吴茜	监事		
12	朱雪君	职工代表监事		

序号	名称	任职	持股数量(万股)	持股比例
13	朱晓玲	副总经理	-	-
14	周小青	副总经理	112.96	0.10%
15	张玲玲	副总经理	38.84	0.03%

注 1：本表中列示的董事、监事和高级管理人员的持股情况不含通过中信建投基金-顾中科技员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有的公司股份。

除上述持有公司股份外，公司董事、监事和高级管理人员均未以其它方式直接或间接持有公司股份。

（二）质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于合肥硕中科技股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴建航

吴建航

廖小龙

廖小龙

中信建投证券股份有限公司

2025 年 9 月 2 日

